

PGA-Fassung 517 Interstitial 32.04 PGA-Fassungen 514/546 Interstitial

Die Kontakte der PGA-Fassungen Serien 517 und 550...112 sind im Grundraster 2,54 mm montiert. Versetzt dazu sind weitere Kontakte angeordnet.

Die Steck- und Ziehkräfte der 6-Lamellen-Kelchfeder aus Beryllium-Kupfer sind bei hohen Polzahlen besonders gering.

Auf Wunsch werden die PGA-Fassungen mit Abstandsnoppen geliefert. Der Luftspalt zwischen Leiterplattenbohrung und Kontakt gewährleistet ein besseres Aufsteigen des Lötzinns.

Finden Sie Ihr Layout nicht auf den Seiten 32.08 - 11, senden Sie uns bitte Ihr Bauteil.

Für Stift
 Ø 0,4 bis 0,56 mm
 ▧ 0,25 x 0,45 mm

Kontaktfeder

Material: Beryllium-Kupfer
 Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm, Gold 0,25 µm, 0,75 µm

Hülse

Material: Messing gedreht
 Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm, Zinn 5 µm (SnPb 90/10)

Isolierkörper hochtemperaturfest (HT)

Thermoplastischer Polyester glasfaserverstärkt, selbstverlöschend nach UL94V0.

Temperatur

Betriebstemperatur -55 bis +125° C
 Lötbeständigkeit 260° C, 10 Sekunden

Kontakttiefe

1,9 bzw. 2,6 bzw. 2,17 mm bei sicherer Kontaktgabe

Einsteckdurchmesser

min. 0,4 mm, max. 0,56 mm

Betriebsspannung

100 V_{RMS}
 150 VDC

Durchschlagsspannung

700 V_{RMS}

Isolationswiderstand

10¹⁰ Ω

Durchgangswiderstand

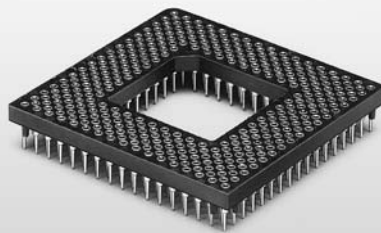
≤ 10 mΩ



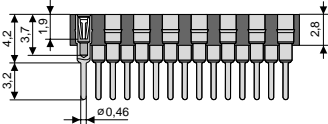
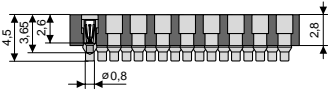
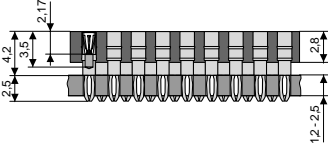
Luft- und Kriechstrecke

> 0,3 mm

Kapazität

< 1 pF



	Hülse 	5 µm Zinn	5 µm Zinn
	Feder 	0,25 µm Gold	0,75 µm Gold
Steck- und Ziehkraft	Bestell-Nr.		
	0,35 N/0,2 N		517-93-XXX-XX-XXX-111
	0,35 N/0,2 N	514-91-XXX-XX-XXX-154	514-93-XXX-XX-XXX-154
	0,35 N/0,2 N	546-91-XXX-XX-XXX-147	546-93-XXX-XX-XXX-147

XXX-XX-XXX = Layout (Seite 32.08 - 32.11)